

第9回 クルマの軽量化技術展

奥野製薬工業(株) 展示会出展のご案内

記

会 期 : 2019年1月16日(水)～18日(金)
10:00～18:00(最終日は17:00終了)
開催場所 : 東京ビッグサイト 東7ホール
小間番号 : E70-70
招待券をお持ちの上、ご来場下さい。

展示製品

◎注目技術

- ・金属材料からの軽量化 次世代樹脂めっきプロセス
- ・樹脂接合用アルミニウム表面粗化プロセス

◎さまざまなプラスチックへのめっきプロセス

- ・プラスチック用装飾電気めっきプロセス
- ・ポリアミド(PA6)用めっきプロセス
- ・炭素繊維強化プラスチック(CFRP)用めっきプロセス

◎パワーデバイス用表面処理

- ・耐クラック性・はんだ接合性に優れた無電解ニッケルめっき液
- ・無電解ニッケル/金、無電解ニッケル/パラジウム/金めっきプロセス
- ・銅素材上への無電解銀めっき液

◎進化するクロムめっき

- ・装飾用3価クロムめっきシリーズ
- ・青黒色3価クロムめっき液

◎アルミニウム/マグネシウム用高耐食性表面処理

製品及び総合技術研究所紹介映像

- ・大幅に工程を削減したクロム・パラジウムフリープラスチックめっきプロセス
～トップゼクロムPLUSプロセス～
- ・総合技術研究所紹介



展示製品

◎注目技術

- ・金属材料からの軽量化 次世代樹脂めっきプロセス「トップゼクロムPLUSプロセス」
- ・樹脂接合用アルミニウム表面粗化プロセス「トップHGボンディングプロセス」

◎さまざまなプラスチックへのめっきプロセス

- ・プラスチック用装飾電気めっきプロセス「TOP DuNCプロセス」
- ・ポリアミド（PA6）用めっきプロセス「ナシオンプロセス」
- ・炭素繊維強化プラスチック（CFRP）用めっきプロセス「トップTFACプロセス」

◎パワーデバイス用表面処理

- ・銅素材上への無電解銀めっき液「トップシルベACC」
- ・無電解ニッケル/金、無電解ニッケル/パラジウム/金めっきプロセス「トップUBPプロセス」
- ・耐クラック性・はんだ接合性に優れた無電解ニッケルめっき液「ICPニコロンLPW-LF」

◎進化するクロムめっき

- ・装飾用3価クロムめっきシリーズ
「トップファインクロム」「トップファインクロムLG」「トップファインクロムFMB」
- ・青黒色3価クロムめっき液「トップファルベBLB Plus」

◎アルミニウム/マグネシウム用高耐食性表面処理

製品及び総合技術研究所紹介映像

- ・大幅に工程を削減したクロム・パラジウムフリープラスチックめっきプロセス
～トップゼクロムPLUSプロセス～
- ・総合技術研究所紹介